

锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

基于审慎原则，结合目前市场环境、半导体行业发展趋势及发展战略与实际情况，公司决定终止本次募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”。并将节余募集资金 131,946,959.87 万元（含利息收入和现金管理收益，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 2 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日